

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

上海润欣科技股份有限公司  
2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票  
预案



Fortune Techgroup  
润欣科技

二零二零年十一月

## 发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。

## 重要提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

二、本次发行面向特定对象发行，发行对象为不超过 35 名特定对象。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。

三、本次发行募集资金总额不超过（含）14,000 万元，即符合向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，适用简易程序；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案	14,600.16	7,900.00
2	高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案	14,070.53	6,100.00
合计		<b>28,670.69</b>	<b>14,000.00</b>

四、本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

五、本次发行股票数量不超过 1,900.00 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

六、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

七、公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定要求，在发行股票预案中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未来三年（2020-2022 年）股东回报规划等情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

八、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

九、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详情请参见本预案“第五节、与本次发行相关的董事会声明及承诺”之“二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施”。

十、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

十一、本次以简易程序向特定对象发行股票方案最终能否获得中国证监会的批准及其他有关部门的审核通过尚存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。特别提醒投资者仔细阅读本预案“重大风险提示”的有关内容，注意投资风险。

## 目 录

<b>发行人声明</b> .....	<b>1</b>
<b>重要提示</b> .....	<b>2</b>
<b>目 录</b> .....	<b>4</b>
<b>释 义</b> .....	<b>6</b>
<b>第一节 本次发行股票方案概要</b> .....	<b>8</b>
一、发行人基本情况 .....	8
二、本次发行的背景和目的 .....	8
三、发行对象及其与公司的关系 .....	12
四、本次发行方案概要 .....	12
五、本次发行是否构成关联交易 .....	15
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .....	15
七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 .....	16
八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序 .....	16
<b>第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</b> .....	<b>17</b>
一、募集资金使用计划 .....	17
二、募集资金投资项目的的基本情况 .....	17
三、募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响 .....	27
<b>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</b> .....	<b>29</b>
一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况 .....	29
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .....	30
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 .....	30
四、本次发行后，公司是否存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形，或公司为实际控制人、控股股东及其关联人提供担保的情形 .....	30
五、本次发行对公司负债情况的影响 .....	31
六、本次发行相关的风险说明 .....	31

<b>第四节 公司利润分配政策及执行情况</b> .....	<b>34</b>
一、《公司章程》中利润分配政策.....	34
二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况.....	35
三、未来三年股东分红回报规划.....	37
<b>第五节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项</b> .....	<b>40</b>
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 .....	40
二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有 关承诺并兑现填补回报的具体措施.....	40

## 释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一、一般性释义		
润欣科技/本公司/公司	指	上海润欣科技股份有限公司
润欣信息	指	上海润欣信息技术有限公司，公司控股股东
领元投资	指	领元投资咨询（上海）有限公司
银燕投资	指	上海银燕投资咨询有限公司
本次发行/本次以简易程序向特定对象发行	指	润欣科技 2020 年度以简易程序向不超过 35 名特定对象（含 35 名）发行 A 股股票的行为
本预案	指	上海润欣科技股份有限公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
报告期	指	2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月
得倍电子	指	上海得倍电子技术有限公司
安路科技	指	上海安路信息科技有限公司
《公司章程》	指	《上海润欣科技股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
二、专业名词释义		
IP（Intellectual Property）和 IP 核	指	即“知识产权”。半导体产业的 IP 通常定义为用于 ASIC 等当中，预先设计好的电路模块。IP 核模块有行为、结构和物理三级不同程度的设计，对应原理和功能设计的称为软核、基于物理实现和工艺验证的称为硬核。
EDA 软件	指	EDA 软件是半导体设计的主要综合工具，大致可分为芯片设计辅助软件、可编程芯片辅助设计软件、系统设计辅助软件。
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。硅晶片上可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品。
Fabless	指	Fabrication（制造）和 less（无）的组合，是全球集成电路设计的主要运作模式，也用来指代不拥有芯片制造工厂的 IC 设计公司，中国大陆几乎所有的芯片设计公司都采用 Fabless 模式，只负责芯片的设计、研发、应用开发和销售，而将晶圆制造外包给专业的晶圆代工厂，封装测试厂。
芯片测试服务	指	设计初期系统级（SoC）芯片测试。SoC 的基础是深亚微米工艺，对 Soc 器件的测试需要采用全新的工程分析方法。由于每个功能元件都有其自身的测试要求，设计工程师需要在设计初期就做出芯片测试的规划。
RSSI	指	Received Signal Strength Indication，接收的信号强度指示，

		无线发送层的可选部分，用来判定链接质量，以及是否增大广播发送强度
SAAS	指	Software-as-a-Service，意思为软件即服务，即通过网络提供软件服务，SAAS 平台供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据工作实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按订购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得 SAAS 平台供应商提供的服务。物联网终端(无线通讯芯片、传感芯片)和 SAAS 数据服务平台配合提供场景服务，是主要的物联网运营和盈利模式。

本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。



## 第一节 本次发行股票方案概要

### 一、发行人基本情况

公司名称	上海润欣科技股份有限公司
公司英文名称	Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	300493
证券简称	润欣科技
注册地址	上海市徐汇区田林路200号A号楼301室
注册资本	47,706.90万元人民币
法定代表人	郎晓刚
营业执照注册号	91310000703034995X
邮政编码	200233
联系电话	021-54264260
传真	021-54264261
公司网站	<a href="http://www.fortune-co.com">http://www.fortune-co.com</a>
经营范围	一般项目：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，第一类和第二类医疗器械的销售，互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 二、本次发行的背景和目的

#### （一）本次发行的背景

##### 1、在国家产业政策的扶持下，大陆集成电路行业发展进入红利期

近五年来，国家高度重视和大力支持集成电路产业的发展，先后出台了一系列促进行业发展的政策。2014年，国务院在《国家集成电路产业发展推进纲要》中部署了集成电路产业中长期的发展目标。2020年，国务院发布《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，在教育、科研、融资、市场应用等各个方面，把大力支持发展半导体产业的自主独立，作为十四五规划的战略发展目标之一。与此相应，国家及各地政府部门出台相应优惠政策，成立了国家和地方的集成电路产业基金，助力中国集成电路产业的发展。

随着大陆智能手机、互联网大数据，以及物联网、汽车电子、5G 等新兴行业的不断涌现和快速发展，2019 年中国大陆半导体整体市场同比增长 12.10%，达到 2.10 万亿元人民币，半导体集成电路销售占全球 35% 的市场份额，为全球第一大市场。在国家产业政策和资本的驱动下，近两年来，中国大陆新落成的晶圆厂占全球新建产能的 50%，大批企业转产半导体集成电路设计和制造，预计到 2030 年，大陆半导体集成电路销售占全球市场份额将提升至 45%。



数据来源：智研咨询

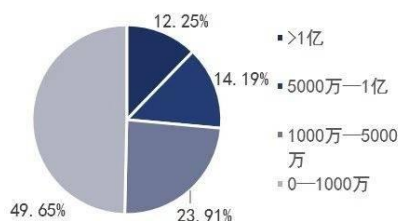
## 2、国内半导体市场供需失衡和结构严重失衡，关键技术受制于人

从市场需求来看，14 亿中国人每年消费了数以亿计的通讯、家电、汽车和各类电子终端产品。中国大陆也是全球最大的电子产品制造中心，半导体集成电路作为核心的电子元器件，源源不断的从美欧日韩等主要半导体生产国进口至中国，已连续 7 年产生超过 2,000 亿美元/年的贸易逆差，大陆半导体市场供需关系失衡。

从产业结构分析，半导体产业技术和资本高度密集，已处于存量竞争的阶段。近 10 年来，全球半导体行业规模增速维持在 4%-6%，少数国际巨头垄断着半导体的主要市场份额、核心资源和专利技术，并不断通过并购整合的方式减少行业竞争，维持其高利润率。

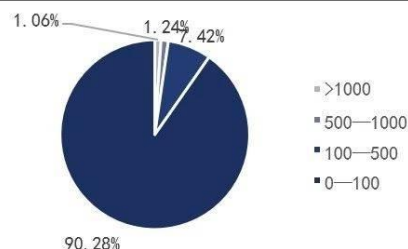
反观中国大陆的半导体产业，2018 年以来半导体设计行业规模增速维持在 30% 以上，大量半导体设计公司扎堆中低端设计市场，90% 的设计公司处于起步阶段，团队不足 100 人，核心 IP、芯片测试、芯片系统应用及运营能力匮乏。

图表 6 2018 年中国 IC 设计企业销售额分布



资料来源：中国半导体行业协会集成电路设计分会，基业常青

图表 7 2018 年中国 IC 设计企业员工分布



资料来源：中国半导体行业协会集成电路设计分会，基业常青

今年 5 月，美国政府的禁令严格限制华为（海思）使用美国技术和软件在美国境外设计和制造半导体。9 月，中国最大的集成电路制造企业中芯国际，也受到了美商务部在关键设备和材料上的出口管制。

半导体行业作为信息产业链最上游，标准化程度和技术壁垒高，国内半导体创业公司往往面对国际巨头在资源和规模上的竞争。芯片研发周期长、成本高昂、需要大量专利技术、工艺制程技术和人才积累，大客户获取机会少，市场不稳定，在 Fabless 模式下，芯片设计公司的产能严重依赖上游晶圆代工和封测厂排期。

纵观国内半导体设计和制造产业链，经过多年的投入和积累，目前中国大陆 IC 设计能力已经取得较为长足的发展，晶圆代工能力、封装能力、系统测试能力以及芯片应用与服务能力也得到了一定提升，但国内在集成电路 IP 核、半导体制造设备、EDA 等方面国产化率仍然处于较低水平。因此，国内半导体设计和制造产业链结构严重失衡，核心技术仍受制于人。

### 3、半导体先进工艺放缓，物联网、人工智能、汽车电子、高清显示等新市场兴起，给市场导向的专用芯片设计带来机会

近十年来，全球半导体工艺制程的更新迭代明显放缓，除了半导体工艺接近极限的物理原因，工艺节点进步在部分新兴行业不再具有优势。14nm 以下先进工艺需要大量的研发和资本投入，全球晶圆厂除台积电、三星、英特尔等少数巨

头外、大多数的晶圆厂放弃了对先进工艺制程的研发项目。此外，采用先进制程的应用场景也集中在手机基带、电脑 CPU、存储等海量大型逻辑芯片上。

随着物联网、人工智能、汽车电子、高清显示等应用场景的兴起，对芯片除品质控制、超低功耗和性价比要求外，还需要融合功率器件、存储、传感器件和算法，在这种碎片化场景的应用市场，以高工艺、高集成度、海量为基础的传统通用型芯片并不适用，针对细分市场开发专用化芯片是最符合性价比的策略。

然而单一细分市场往往空间有限，难以支撑一家技术导向型半导体设计公司的长期发展。半导体产业设计周期长，半导体设计公司既要保持芯片产品的技术领先，又需要不断扩展新的市场，需要长期的投资和市场积累。公司是国内领先的 IC 和应用方案提供商，在物联网行业等细分市场有着深厚的技术和客户资源积累。因此，润欣科技针对细分市场定制专用化芯片方面具有独特优势。

## （二）本次发行的目的

公司是国内领先的 IC 产品分销和解决方案提供商，主要通过向客户提供包括 IC 应用方案在内的技术支持服务，形成 IC 产品的销售。公司的主营业务以无线连接芯片、射频元器件和 MEMS 传感器模块为主，是 IC 产业链中连接上下游的重要纽带。近年来，公司持续增加在无线通讯、射频和 MEMS 传感芯片的研发投入，智慧家居、TWS 无线耳机、混合模拟信号等市场的业务增长显著。未来公司将继续保持无线通讯领域的领先优势，积极拓展无线芯片定制、射频元器件、MEMS 传感器、5G 通讯模块等在智慧家居、智能穿戴、智慧交通、未来教育等领域的应用。

在我国半导体集成电路的产业政策推动和智能物联网、汽车电子等新兴产业迅猛发展的背景下，公司需要利用国产化替代和芯片定制设计的机会，向上游芯片设计服务和 IC 应用领域拓展。

本次募集资金投资项目主要围绕公司现有业务及 IC 系统方案展开，符合国家对于半导体集成电路的产业政策，符合公司向上游芯片设计领域拓展的长远发展战略，聚焦公司的优势细分市场，增加公司自主知识产权的投资力度、补齐短板，加强和产业链上下游的协同发展。本次募集资金投资项目采取以市场为导向

的芯片定制与半定制化整合策略，可以提高系统集成度和产品性价比；在提升公司在EDA工具、IP核、综合测试的全方位服务能力的同时，可以为中小芯片设计公司提供IP和晶圆代工厂的配额保护，降低综合成本。本次募集资金投资项目有助于增强公司在智能物联网和高清LED驱动和控制领域的业务优势，能够明显提升公司的自主研发和盈利能力，增强核心竞争力。

### 三、发行对象及其与公司的关系

本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名（含35名）。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

截至本预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在询价结束后公告的《募集说明书》中予以披露。

### 四、本次发行方案概要

#### （一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元。

#### （二）发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

#### （三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

在本次发行竞价实施时，上市公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺：参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的关联关系，不得主动谋求发行人的控制权。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

#### （四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。

### （五）发行数量

本次发行的股票数量不超过1,900.00万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

### （六）限售期

本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让。

本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

### （七）募集资金总额

本次发行股票募集资金总额不超过（含）14,000.00万元，即符合向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，适用简易程序。

### （八）募集资金投向

本次发行股票募集资金总额不超过（含）14,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金
----	----------	--------	---------

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案	14,600.16	7,900.00
2	高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案	14,070.53	6,100.00
合计		<b>28,670.69</b>	<b>14,000.00</b>

如本次实际募集资金量少于计划，项目投资总额的缺口部分将由公司通过自筹资金的方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的建设进度，对募集资金投入金额和顺序进行适当调整。鉴于募投项目对公司发展的必要性和紧迫性，在募集资金到位前，公司将根据项目建设需要以自有资金先行投入并实施上述项目，募集资金到位之后，以募集资金置换预先已投入项目的自有资金。

#### （九）滚存未分配利润安排

本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

#### （十）上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

#### （十一）本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起，至上市公司 2020 年度股东大会召开之日止。

### 五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

### 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，润欣信息为公司的控股股东，持有上市公司 30.07% 股权；郎晓刚、葛琼夫妇通过润欣信息、领元投资、银燕投资共同控制公司 41.14% 的股权，为公司实际控制人。



本次发行股票募集资金总额不超过（含）14,000.00万元，即符合向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，适用简易程序。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，本次发行完成后郎晓刚和葛琼夫妇仍为公司实际控制人。

本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

## 七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件

本次以简易程序向特定对象发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

## 八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序

### （一）本次发行已取得的授权和批准

本次发行已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

### （二）本次发行尚需获得的授权、批准和核准

- 1、临时股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
- 2、公司董事会审议通过本次发行具体方案。
- 3、深交所审核并作出上市公司是否符合发行条件和信息披露要求的审核意见。
- 4、中国证监会对上市公司的注册申请作出注册或者不予注册的决定。

## 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 14,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案	14,600.16	7,900.00
2	高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案	14,070.53	6,100.00
合计		<b>28,670.69</b>	<b>14,000.00</b>

如本次实际募集资金量少于计划，项目投资总额的缺口部分将由公司通过自筹资金的方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的建设进度，对募集资金投入金额和顺序进行适当调整。鉴于募投项目对公司发展的必要性和紧迫性，在募集资金到位前，公司将根据项目建设需要以自有资金先行投入并实施上述项目，募集资金到位之后，以募集资金置换预先已投入项目的自有资金。

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

#### （一）无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目

##### 1、项目基本情况和经营前景

“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目”预计投产期 3 年，自 2021 年至 2023 年；运营期 5 年，自 2021 年至 2025 年。本项目实施主体为上海润欣科技股份有限公司。项目投资总额为 14,600.16 万元，拟用于综合产测设备、芯片应用开发工具、SAAS 数据服务平台、核心 IP 及模块定制设计、研发开支、原材料采购与加工等。通过该项目的实施，公司将进一步增强在智能物联网行业的核心竞争力，提升公司在半导体应用设计领域的盈利能力。

本项目所开发的芯片、模块和 IC 系统方案，主要针对超低功耗无线信标和感知定位系统，可广泛应用于智慧城市及物联网领域，教育、智能家居、新零售、室内停车、智慧医疗、智慧农业等场景，可以低成本实现贵重资产和重点被保护

人群（如老人、幼儿、病人、宠物、牲畜等）的位置、轨迹和体征管理。其电子围栏设置，对于幼儿园、学校、博物馆、展会等重要区域，可以防止人员未经授权进入，或者感知物品离开定位区域，超出设定区域，后台数据会自动记录信息，并及时通知管理人员。

其中，本项目所开发的微能量收集芯片和模块，能够利用收集射频电磁、温差、光线等微弱能量，达到无需蓄电池实现数据采集和无线传输的目的；资产信标采用超低功耗优化芯片，大大降低了信标定位功能所需的能耗，带有信标的物品/人员通过定期和周围定位模块的信息交互，实现在室内环境 0.5~1 米的精确定位；终端嵌入式软件上设计了专用的位置处理引擎以减少唤醒处理器，结合状态和模式检测以降低传感器的使用频率，进一步降低功耗；定位信标(Beacon)系统的设计上采用了温度传感、磁传感器、蓝牙 Mesh、BLE/WiFi 网关和蜂窝通讯技术，采用基于 RSSI 的射频侧向功能，以提高信标室内覆盖的效率；通过公有云的 SAAS 设计，导入地图定位、资产管理和数据服务，云平台对接收到的数据进行相应的处理并储存，便于实时查询和数据统计，对用户、设备、监测数据等信息进行管理，并及时反馈给管理人员。



如上图所示，本项目所形成的 IC 系统方案包括四个产品，从左至右依次依次为 1/蓝牙信标，2/无线模块（带温度、地磁等传感器），3/无线网关，4/SAAS 资产定位和数据服务平台，根据中小企业、医疗机构、学校、港口仓储行业的需求配置服务平台和终端的数量，采用软件授权、芯片+模块销售和服务相结合的市场营销模式。本项目计划应用在中小企业、学校、医院养老机构、零售超市等场景。

## 2、项目实施的必要性

### （1）低功耗无线信标及传感芯片的市场前景广阔

智能物联网技术正在全球范围内引发新一轮的产业变革，成为推动经济社会发展的重要力量，作为 IOT 感知网络的基础定位技术，蓝牙信标定位系统是其

中发展较快、最为重要的组成部分之一。物联网在给人们生活提供便利的同时也推动了室内低功耗信标芯片和传感器芯片技术的发展，智慧城市、港口、医疗、教育、展会等行业对资产定位追踪和门禁安防、电子围栏等技术有着较大需求，亟需通过稳定可靠的窄带物联网芯片应用技术实现低功耗、感知和数据管理的端到端解决方案。

根据市场调研机构 Market & Market 预测，全球室内定位及传感市场的规模将由 2018 年 100 亿美元增长到 2022 年的 409.9 亿美元，年复合增长率 42%，与此相应，中国大陆的室内定位及传感市场规模逐渐扩大，整体行业发展态势良好。高精度、快速、及时的室内定位将加速数据信息流通，改变传统零售、安防、制造、养殖等领域的运作方式，从而真正实现万物互联。

根据 ABI 研究机构提供的报告表明，物流、资产、重点人群管理和溯源、感知、定位的软硬件和数据服务业增长迅速，中国大陆的市场规模由 2014 年的 9.3 亿元上升至 2018 年的 35 亿元，年复合增长率达 39.30%，预计到 2023 年，大陆无线室内定位及传感行业的市场规模将达到 175.10 亿元，其中蓝牙无线信标及传感芯片年需求量超过 5 亿片，成长空间广阔。

## **(2) 室内定位及感知服务的市场需求明确**

随着万物互联时代的来临，社会生活各个层面对室内定位及感知服务的需求不断增加，主要包括中小企业管理、特殊人群监护、未来教育、新零售价签等。

### **① 中小企业门禁和资产管理**

蓝牙信标和室内定位系统可与门禁系统结合，用于企业员工考勤和访客权限，重要资产设备、货物上加贴信标，可为资产盘点、防丢失、移动轨迹管理提供便利。阿里云和钉钉智慧办公平台计划向中小企业，学校客户提供资产定位和考勤管理系统，结合云钉门禁系统提供资产安全、访客权限、学生考勤等服务，增加智能办公和未来教育平台的客户注册和日活数量。

### **② 重点人群监护**

信标和室内定位系统可用于幼儿、病人、老年人等特殊人群的监护：1) 幼儿园利用电子围栏系统将孩子到校离校，以及在校的轨迹告知给家长，让家长

随时了解孩子的安全状态；2) 医院可让病情特殊病人携带指标监视器，当病人身体状况出现波动，立即向医生通报病人位置以便及时开展急救；3) 在养老院，定位信标和系统可以感知老人的心率、体温、摔倒等状态，提高护理的实时性和效率。公司已和国内数家医疗设备客户开展芯片（外购）和产品层面的合作。

### ③资产安全和应急救援辅助

在紧急情况如发生台风水灾、火灾时，信标和室内定位技术可以帮助货物、车辆的主人及救援人员及时了解当前的火情和店铺、车库水淹状况，以快速开展救援行动，保障资产和人员安全。公司正在和珠海横琴等岛屿、港口区域进行资产安全和数据服务层面的项目合作。

### (3) 完善公司在窄带物联网的产业布局，增强公司的自主研发和盈利能力

润欣科技作为专注于无线连接、射频和传感技术的 IC 分销及应用方案提供商，是国际一线的通讯芯片设计公司在中国本土的授权代理商，近年来的中美贸易摩擦及禁售政策，使得公司在通讯、安防、精密工业等领域的业务受到一定限制，部分国内客户在选择关键芯片产品时也会优先考虑国产芯片和供应链稳定的因素。国产 IC、核心专利和系统方案的自主研发如箭在弦。

物联网、无线信标及传感系统是公司未来长期规划的领域，国家“十四五”规划的产业扶持政策将会拉动新基建、智慧城市、智慧医疗等朝阳产业的发展。依靠多年积累的客户、研发和芯片应用方案资源，公司计划在超低功耗无线信标、MEMS 传感器、模组整合封装和芯片应用整体方案上持续投入，通过自研的方式延伸到产业链的上游，整合芯片设计平台、IP 核、芯片测试服务、定位服务系统等上下游环节，抓住国产化替代的市场机会，成为国内在低功耗无线信标和定位感知市场的技术领先者。

## 3、项目实施的可行性

### (1) 政策支持是项目实施的有利保障

随着物联网技术水平和创新能力的提高，室内定位的发展势头良好，国家相关部门高度重视并出台了一系列利好政策以促进物联网技术在生产、生活中的应用。具体如下：

序号	法律法规 产业政策	发布单位	颁布时间	主要内容
1	《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》	国务院	2013 年 2 月	把握技术发展方向,围绕应用和产业急需明确发展重点,加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化,着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术,加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新,推进物联网与新一代移动通信、云计算、下一代互联网、卫星通信等技术的融合发展。
2	《室内外高精度定位导航白皮书》	中国科技部	2013 年 9 月	正式推出室内外定位导航系统——羲和系统,该系统具备室外亚米级、室内优于 3 米的无缝高精度定位导航能力,并在北京、天津、湖北、上海等取得了良好的应用示范效果。中国科技部对羲和系统提出发展目标,2015 年前,在中国 10 个城市、三个行业开展羲和系统示范工程建设,逐步向全国推广,并开展在大众位服务、交通出行服务、物联网、智慧城市、精准农业、应急数援等领域的应用示范。
3	《“十三五”国家信息化规划》	国务院	2016 年 12 月	提出建设“数字中国”的发展目标,涵盖经济、政治、文化、社会、生态等各领域信息化建设,包括“宽带中国”、“互联网+”、大数据、云计算、人工智能、数字经济、电子政务、新型智慧城市、数字乡村等内容。
4	《信息通信行业发展规划(2016-2020 年)》	中国工信部	2016 年 12 月	到 2020 年,具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成,包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破 1.5 万亿元,智能信息服务的比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局,公众网络 M2M 连接数突破 17 亿。

## (2) 公司在半导体上下游供应链拥有良好的技术资源

本次募投项目采用的无线信标芯片和感知芯片技术较为成熟,初始版本已在国内晶圆厂完成流片,开发板和样品测试符合市场设计要求。这为公司整合芯片设计平台、拓展晶圆制造和模块封装渠道奠定了基础。立足于多年的芯片应用方案技术积累,公司购买及自主研发的 IC 系统软件、算法和 SAAS 定位感知服务系统也正在规划中。

## (3) 公司与下游优质客户在物联网应用领域合作多年

近年来，公司在芯片应用方案、客户营销、物流仓储、供应链运作等方面取得了长足的进步，在物联网应用领域和美的集团、大疆创新、华三通讯、阿里钉钉等优质客户建立了良好的合作关系。

#### (4) 公司在无线信标和定位感知领域有着深厚的技术及人才储备

公司经过长期积累，拥有全套的无线信标芯片嵌入式开发工具、源代码、IP协议栈、定位数据服务软件、专利和知识产权。目前公司在上海、深圳、台湾设有研发中心，核心研发工程师均有15年以上无线连接、射频和传感器行业工作经历，具备系统集成、软硬件设计开发和综合测试能力。

#### 4、项目投资概算

本项目投资总额为14,600.16万元，主要包括综合产测设备、芯片应用开发工具、SAAS数据服务平台、核心IP及模块定制设计、研发开支、原材料采购与加工等，本项目拟使用募集资金7,900.00万元。项目投资预算及预计投入进度安排如下：

单位：万元

项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	合计
综合产测设备	600.00	800.00	100.00	-	-	1500.00
芯片应用开发工具	200.00	150.00	150.00	-	-	500.00
SAAS数据服务平台	100.00	100.00	100.00	-	-	300.00
核心IP及模块定制设计	900.00	700.00	-	-	-	1,600.00
研发开支	775.00	850.00	975.00	450.00	450.00	3,500.00
原材料采购及加工	1,800.04	1,772.07	1,800.04	1,828.01	-	7,200.16
<b>合计</b>	<b>4,375.04</b>	<b>4,372.07</b>	<b>3,125.04</b>	<b>2,278.01</b>	<b>450.00</b>	<b>14,600.16</b>

#### 5、研发开支情况

本项目研发开支合计3,500万元，研究和开发内容包括：低功耗蓝牙信标芯片、传感器模块的IC应用方案设计、芯片应用开发板设计、无线网关的软硬件设计、传感器算法，SAAS位置服务平台软件开发，资产与重点人群定位系统集成等。

公司经过长期积累，拥有全套的无线信标芯片嵌入式开发工具、源代码、IP协议栈、定位数据服务软件、专利和知识产权。目前公司在上海、深圳、台湾设

有研发中心，核心研发工程师均有15年以上无线连接、射频和传感器行业工作经历，具备系统集成、软硬件设计开发和综合测试能力。

## 6、项目实施周期

本项目预计投入及运营期5年，自2021年至2025年。公司将根据实际需求情况，动态调整本项目的实施进度。

## 7、项目的效益分析

本项目运营期（含投入期）年均收入为17,320.00万元，年均税后净利润为1,284.03万元，税后静态投资回收期为4.56年（含建设期3年），税后项目财务内部收益率为16.69%。

## 8、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的情况

本项目实施后主要提供IC等电子元器件的推广、销售及应用服务，无环境污染及排放物，符合国家相关环保标准和要求。本项目的发改委备案正在办理中。

### （二）高清LED驱动、控制芯片与IC系统方案项目

#### 1、项目基本情况和经营前景

“高清LED驱动、控制芯片与IC系统方案项目”预计投产期3年，自2021年至2023年；运营期5年，自2021年至2025年。本项目实施主体为上海润欣科技股份有限公司。项目投资总额为14,070.53万元，拟用于综合封测设备、净化实验室建设、芯片测试车间及配套，以及光罩、样片及设计工具，研发开支、原材料采购及加工等。公司规划与IC设计公司合作，开发高清LED驱动、控制芯片的IC应用方案，同时负责整合晶圆制造厂配额，设计工具，及特殊封测工艺的成本优化。通过该项目的实施，公司规划逐步向上游IC产业链拓展，降低芯片综合成本，提升公司的自主研发和盈利能力。

本项目系开发LED驱动和控制系统，提供系统集成和综合测试服务，通过自主流片缩短供货流程，保障配额和IP核的自主可控。通过提高产能和封测集成度，降低芯片成本。

#### 2、项目实施的必要性



## （1）LED 驱动芯片市场前景广阔

LED 驱动芯片是伴随着 LED 芯片三原色技术突破和应用不断拓展发展起来的；LED 驱动芯片产品科技含量高、更新迭代快，为应对市场需求不断变化，包括芯片设及其材料、工艺、技术的全产业链需要持续的创新。

LED 驱动芯片行业发展日趋成熟，相较于国际大厂，国内整体技术水平已迎头赶上，国内驱动芯片企业在国际上竞争力显著提高，尤其是在芯片性价比方面有极大优势。未来几年，政策驱动、行业技术路径和发展趋势、市场需求等多重优势利好 LED 驱动芯片行业发展，预计未来 5 年的复合年增长率 27%。

根据 LEDinside 研究显示，2019 年全球 LED 显示市场规模达 63.35 亿美元，其中中国市场占比 48.8%，为第一大市场。全球排名前五的显示屏厂商利亚德、洲明、强力、三思、艾比森，全部为中国本土企业，中国制造的全球占比超过 80%。作为 LED 显示的核心芯片，国内 LED 驱动芯片的市场规模达到 46.50 亿元人民币，年复合增长率 26%。Micro LED 显示屏的主要市场，从机场、大型体育场馆、商场显示屏，到高清会议视频显示、高清晰影院、高端家庭影院，发展空间广阔。随着宽频、低时延、高速 5G 网络的建设，8K 高清 LED 显示屏市场即将进入成长爆发期，公司规划通过本次募投项目，配合优势的 5G 通讯模块和 FPGA（逻辑器件）产品线，在 LED 显示屏驱动与控制芯片领域增加投资和研发投入，提高产品集成度和性能、上下游协同发展。

## （2）八英寸晶圆代工市场产能严重不足，亟需拓展供应链渠道

LED 显示驱动芯片属于模数混合芯片，需要采用八英寸晶圆代工。近十年来，先进工艺多采用 12 寸晶圆代工，资本支出规模巨大，部分晶圆厂商停止了 8 寸晶圆的生产销售，8 寸晶圆产能多来自从 8 寸向 12 寸升级的内存厂商。8 寸晶圆设备如蚀刻机、光刻机及芯片测量设备紧缺。

根据 SEMI 的数据预测，到 2022 年，全球的 8 寸晶圆制造厂的总产能约为每月 650 万片晶圆。而近年来，随着智能手机的升级，人工智能、5G、物联网、汽车电子等新兴市场的出现，指纹识别芯片、MEMS 传感器、LED 驱动 IC、电源管理芯片、功率器件和 Nor Flash 等元器件的需求出现飙升，各晶圆厂的原有

八英寸产线爆满，结构性缺货和涨价持续了将近 20 个月，芯片制造与封测订单已经排到明年一季度，芯片交期从 10 周延长至 16 个月以上，中小芯片设计公司苦不堪言。

在此背景下，公司垂直整合 LED 显示驱动和控制系统，集成晶圆代工配额、EDA 工具、综合测试和供应链运营，可以舒缓中小芯片设计公司的资金压力。提升产品集成度和性价比，符合公司向上游芯片设计领域拓展的发展战略。

### 3、项目实施的可行性

#### (1) 公司与 LED 显示驱动芯片设计公司建立了稳定的合作投资关系

公司从拓展上游半导体设计业务的业务需求出发，与传统 LED 驱动芯片设计厂商上海得倍电子有限公司进行合作并对其投资。公司已与得倍电子签署《合作与投资意向书》，计划在高清 LED 驱动芯片设计、数据通讯接口模块、智能 LED 控制系统开发、高速视频传输接口芯片设计等领域开展业务合作。公司向得倍电子支付 1,000 万元人民币作为投资意向金，计划以得倍电子投后 2.2 亿人民币的估值对得倍电子进行增资，获得其 19.9% 的股权。

得倍电子作为 LED 驱动芯片领域技术领先的设计公司，将会为本募投项目提供 IC 设计服务，其成熟的 IC 设计技术和 LED 客户渠道资源，为本项目的顺利实施提供有力保障。

#### (2) 公司与上海安路信息科技有限公司合作开发 LED 控制芯片市场

FPGA 是作为专用集成电路领域中的半定制电路，2019 年全球 FPGA 市场规模达到 69 亿美元，长期以来，由于技术、资金、设计人才的壁垒，美国设计公司 Xilinx 和 Altera 分别占据全球市场 56% 和 31% 份额。中国 FPGA 市场规模约 100 亿人民币，随着 5G 部署和高清 LED 控制市场的发展，国产厂商在 FPGA 领域国产替代空间广阔。安路科技作为国产 FPGA 设计的龙头企业，在 LED 显示控制市场的占有率保持高速增长，其推出的 ELF2 FPGA 芯片，具有 IO 更多，封装更小，集成传输接口以及内嵌微处理器的特性，可以满足对 MicroLED 显示屏的发展需求，FPGA 在信号处理能力、混合电平控制效率和稳定性上有很大的性能提升。此外，模数混合的半定制一体化系统设计，可以对通信模块、LED

控制及驱动芯片同步供电，提高系统集成度、降低功耗。有利于提高公司在LED驱动与控制领域的产品竞争力和盈利能力。

#### 4、项目投资概算

本项目投资总额为14,070.53万元，主要包括综合封测设备，净化实验室建设，芯片测试车间及配套，光罩、样片及设计工具，研发开支，原材料采购及加工等，本项目拟使用募集资金6,100.00万元。项目投资预算及预计投入进度安排如下：

项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	合计
综合封测设备	1,000.00	500.00	100.00	-	-	1,600.00
净化实验室建设	100.00	200.00	-	-	-	300.00
芯片测试车间及配套	50.00	50.00	200.00	-	-	300.00
光罩、样片及设计工具	380.00	320.00	300.00	-	-	1,000.00
研发开支	500.00	550.00	600.00	250.00	250.00	2,150.00
原材料采购及加工	1,453.42	1,453.42	2,906.84	2,906.84	-	8,720.53
<b>合计</b>	<b>3,483.42</b>	<b>3,073.42</b>	<b>4,106.84</b>	<b>3,156.84</b>	<b>250.00</b>	<b>14,070.53</b>

#### 5、研发开支情况

本项目研发开支合计2,150.00万元，用于借助EDA综合工具和不同芯片设计公司的IP核设计，配合外部逻辑电路，根据各种不同半导体工艺，设计成可量产可测试的全套工艺文件、LED控制芯片及驱动芯片的IC系统方案开发等。

本项目研发完成后，公司将具备成熟的高清LED驱动、控制芯片的应用方案设计，并提升公司在模拟数字混合芯片测试工艺和LED显示控制系统的设计能力。

#### 6、项目实施周期

本项目预计投入及运营期5年，自2021年至2025年。公司将根据实际需求情况，动态调整本项目的实施进度。

#### 7、项目的效益分析

本项目运营期（含投入期）年均收入为 19,000.00 万元，年均税后净利润为 1,369.60 万元，税后静态投资回收期为 4.57 年（含建设期三年），税后项目财务内部收益率为 19.52%。

## 8、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的情况

本项目实施后主要提供 IC 等电子元器件的推广、销售及应用服务，无环境污染及排放物，符合国家相关环保标准和要求。本项目的发改委备案正在办理中。

## 三、募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响

### （一）本次募集资金运用对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司现有业务及 IC 应用方案展开，募投项目完成后，公司的经营模式不会发生变化。本次募集资金投资项目符合国家对于半导体集成电路的产业政策，聚焦润欣科技的优势细分市场，增加公司自主知识产权的投资力度、补齐短板，加强和产业链上下游的协同发展。本次募集资金投资项目有助于增强公司在智能物联网和高清 LED 显示领域的业务优势，提升公司的核心竞争力。

### （二）本次募集资金运用对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成对公司财务状况的影响如下：

#### 1、本次募集资金运用对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加，负债总额不变，资产负债率将相应下降，本次发行有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，优化资本结构。

#### 2、本次募集资金运用对公司盈利能力的影响

本次募集资金投资项目实施后，公司预期能够获得协同效应和规模效益，提升公司的整体盈利能力。综上，项目实施完毕后将有利于提高公司营业收入和利润的整体规模，进而提升公司的盈利能力。

#### 3、本次募集资金运用对公司现金流量的影响

本次发行完成后，募集资金的到位将使得公司筹资活动现金流入大幅增加；随着募投项目的陆续实施，未来公司的投资活动现金流出将有所增加；随着募投项目收益逐渐实现，未来公司的经营活动现金流量将有所增加。本次向特定对象发行将进一步优化公司整体现金流状况。

### 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

#### 一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况

##### （一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次发行所募集的资金，将有利于本公司主营业务的发展，本公司的行业地位、业务规模都有望得到进一步的提升和巩固，核心竞争力将进一步增强。

##### （二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。本公司将按照发行的实际情况对公司章程中关于公司注册资本、股本结构及与本次发行相关的事项进行调整，并办理工商变更登记。

##### （三）本次发行对股本结构的影响

截至本预案公告日，润欣信息为公司的控股股东，持有上市公司 30.07% 股权；郎晓刚、葛琼夫妇通过润欣信息、领元投资、银燕投资共同控制公司 41.14% 的股权，为公司实际控制人。

本次发行股票募集资金总额不超过（含）14,000.00 万元，即符合向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，适用简易程序。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，本次发行完成后郎晓刚和葛琼夫妇仍为公司实际控制人。

##### （四）本次发行对高管人员结构的影响

截至本预案公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划，本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司在未来拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

##### （五）本次发行对业务结构的影响

本次发行完成后，公司主营业务仍为IC产品分销及提供应用解决方案。公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

## 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

### （一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加，负债总额不变，资产负债率将相应下降，本次发行有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，优化资本结构。

### （二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行募集资金到位后，公司净资产和总股本将有所增加，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但本次发行完成后，公司的资金实力将得到明显提升，随着募投项目逐步实现效益，有助于扩大公司现有业务的规模，从而逐步提升公司的盈利能力。

### （三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入量将有所增加，并有效缓解公司日益增长的日常营运资金需求所致的现金流压力。总体来看，本次发行有助于改善公司现金流量状况，降低经营风险与成本。

## 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人不发生变化。公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面不会发生重大变化。

## 四、本次发行后，公司是否存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形，或公司为实际控制人、控股股东及其关

## 联人提供担保的情形

本次面向特定对象发行股票完成后公司不存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为实际控制人、控股股东及其关联人提供担保的情形。

## 五、本次发行对公司负债情况的影响

截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并报表口径的资产负债率为 27.74%。本次发行全部以现金认购，假设按照募集资金金额 14,000 万元计算，本次发行完成后，公司的资产负债率将下降至约 24.48%。因此，本次发行能够进一步优化公司的资产负债结构，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力。

本次发行不会导致公司出现负债比例过低、财务成本不合理的情况，也不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

## 六、本次发行相关的风险说明

### （一）市场风险

公司是国内领先的 IC 产品分销和解决方案提供商，公司的主要客户为国内的电子产品制造商，分布在智能手机、物联网和汽车电子等领域。公司本次面向特定对象发行股票募集资金计划向智能物联网和高清 LED 显示领域的业务领域拓展，在细分领域实现单点突破和技术创新，获取国产化替代的市场红利。若上述领域的市场环境不景气，需求下降，公司的经营业绩将受到不利影响。同时，在业务发展中，若公司在下游市场发展的判断上出现重大失误，没能在快速成长的应用领域配置相应的 IC 产品和技术服务，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

### （二）募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金主要拟投向“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目”和“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案项目”，项目通过自研的方式延伸到产业链的上游，整合芯片设计平台、IP 核、终端设备、定位服务系统



等上下游环节，项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然公司的募集资金投资项目已经过详细的论证，具备人才、技术、市场各方面的充分准备，但也可能因为发行人对上下游资源整合不及预期，或者因为宏观经济、政策环境、项目建设进度、设备供应等方面的变化，对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

### （三）供应商变动风险

公司的上游供应商是 IC 产品设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有重要意义。如果公司与主要上游 IC 设计制造商的合作授权关系出现变化，将会对公司电子元器件分销业务的经营业绩造成重大不利影响。

### （四）客户变动风险

公司的下游客户主要是电子产品生产制造商。未来如果因市场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动，或者公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，或者其他竞争对手出现导致公司主要客户群体发生不利于公司的变化，或公司下游客户调整采购策略，由向分销商采购转为直接向上游 IC 设计制造商直接采购，将使公司面临部分客户变动的风险，从而对公司业绩造成不利影响。

### （五）应收账款发生坏账的风险

公司近几年随着业务规模的持续扩大，营业收入增长较快，应收账款账面价值也逐年增长。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 33,580.09 万元、34,440.48 万元、30,732.47 万元和 32,983.72 万元，占流动资产的比例分别为 32.27%、34.52%、41.30%和 32.65%。尽管报告期内公司客户质量良好，且超过一半的应收账款账龄在一年以内，但如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。

### （六）即期回报被摊薄的风险

本次发行后，公司总股本将相应增加，由于募集资金使用效益真正发挥出来需要有一定的时间，因此，短期内公司的净资产收益率、每股收益等财务指标将

可能出现一定程度的摊薄。未来随着公司的持续经营和稳步发展，公司的净资产收益率和每股收益将逐步上升。

### **（七）股票价格波动风险**

上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。

### **（八）本次向特定对象发行 A 股股票的审批风险**

公司本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需取得深交所审核和中国证监会的批准。公司本次面向特定对象发行股票能否取得相关批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在一定不确定性。

### **（九）新冠疫情风险**

新冠疫情的爆发，对全球 IC 产业链，国内电子产品制造客户均带来不同程度的影响，如果全球疫情持续发展，消费电子、汽车电子等市场在年内难以恢复，将对公司业绩造成不利影响。

## 第四节 公司利润分配政策及执行情况

### 一、《公司章程》中利润分配政策

为更好的保障投资者权益，根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件的规定，上市公司现行最新《公司章程》中关于利润分配政策具体内容如下：

#### （一）公司利润分配政策的基本原则

- 1、应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
- 2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
- 3、优先采用现金分红的利润分配方式；
- 4、充分听取和考虑中小股东的要求；
- 5、充分考虑货币政策环境。

#### （二）公司利润分配具体政策

##### 1、利润的分配形式

公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

##### 2、现金分红的具体条件和比例

公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于 15%的（不含 15%），应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%；公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在 15%以上（包括 15%），不满 30%的，应当采取现金方式分配股利，以现金方式

分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%；公司在一年内有重大资金支出安排，可根据具体情况进行现金方式分配股利。

**（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策**

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上（包括 30%）的事项。根据本章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。

**（四）发放股票股利的具体条件**

公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，且在不影响上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。

## **二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况**

**（一）最近三年利润分配方案**

公司近三年的普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案情况如下：

**1、公司 2017 年度利润分配方案**

2017 年度，公司因处于非公开发行股票发行阶段，公司董事会决定 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，并经 2017 年度股东大会审议通过。基于公司 2017 年度的财务情况，为了切实维护中小投资者的利益，与

投资者共享公司的发展成果，公司控股股东润欣信息提议公司在非公开发行股票工作完成后，在2018年中期以公司截至2018年6月30日的股份总数为基数，对公司进行一次利润分配，以现金方式分配的利润不低于公司2017年度实现的可分配利润的30%，即2018年中期公司以现金方式分配的利润将不低于15,085,546.18元。

## 2、2018年中期利润分配方案

2018年中期利润分配预案经2018年第二次临时股东大会审议通过，以截至2018年6月30日公司总股本318,045,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共分配现金股利31,804,597.50元，不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

## 3、公司2018年度利润分配方案

2018年度利润分配及资本公积转增股预案经公司2018年度股东大会审议通过，以截至2018年12月31日公司总股本318,045,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。合计向全体股东派发现金股利25,443,678元，公积金转增股本159,022,987股，分红后公司总股本增至477,068,962股。

## 4、公司2019年度利润分配方案

2019年度利润分配预案经公司2019年度股东大会审议通过，以截至2019年12月31日公司总股本477,068,962股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）。

### （二）最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下所示：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的 净利润	现金分红金额占合并报表 中归属于上市公司普通股 股东的净利润的比率
2019年	9,541,379.24	29,345,234.09	32.51%
2018年	57,248,275.50	15,776,057.22	362.88%

2017年	0.00	54,414,796.29	0.00%
-------	------	---------------	-------

### （三）最近三年未分配利润的使用情况

公司实现的归属于母公司所有者的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后,当年的剩余未分配利润结转至下一年度,主要用于公司的日常生产经营,补充流动资金,有利于增强公司的资金实力,提高公司的抗风险能力,满足公司经营的资金需求,实现公司健康可持续发展。

## 三、未来三年股东分红回报规划

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》，股东分红回报规划主要内容如下：

### （一）公司制定本规划考虑的因素

公司充分考虑投资者的回报,每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利,在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见。

### （二）本规划的制定原则

- 1、应重视对投资者的合理投资回报,不损害投资者的合法权益;
- 2、保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远和可持续发展;
- 3、优先采用现金分红的利润分配方式;
- 4、充分听取和考虑中小股东的要求;
- 5、充分考虑货币政策环境。

### （三）未来三年（2020-2022年）的具体股东回报规划

1、利润的分配形式:公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

2、现金分红的具体条件和比例：公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于 15%的（不含 15%），应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%；公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在 15% 以上（包括 15%），不满 30%的，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%；公司在一年内有重大资金支出安排，可根据具体情况进行现金方式分配股利。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30% 以上（包括 30%）的事项。根据本章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。

4、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，且在不影响上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。

#### （四）利润分配方案的决策机制

公司利润分配的审议程序如下：

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研

究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

### （五）股东回报规划的制定周期和相关决策机制

公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。

公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应充分听取独立董事、外部监事和公众投资者意见。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事同意，方可提交公司股东大会审议。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。



## 第五节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项

### 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次发行外，在未来十二个月内，公司董事会将根据公司资本结构、业务发展情况，并考虑公司的融资需求以及资本市场发展情况，除本次向特定对象发行外，确定是否安排其他股权融资计划。

### 二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施

#### （一）本次发行对公司财务指标和即期回报摊薄的影响

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。具体计算分析过程如下：

#### 1、主要假设、前提

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会核准并发行的实际情况为准，具体假设如下：

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

（2）假设公司于2020年11月底完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投

资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会实际通过本次发行注册完成时间为准）；

(3) 假设本次发行股票募集资金总额为 14,000.00 万元，暂不考虑相关发行费用；发行股份数量上限为 19,000,000 股。根据本次发行方案，本次发行股份数量上限不超过本次发行前上市公司总股本 477,068,962 股的 30%。

上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；本次发行实际募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

(4) 公司 2019 年属于母公司股东的净利润为 2,934.52 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,472.33 万元。以 2019 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，减除计提商誉减值的影响，并增加计入非经常性损益的政府补助作为模拟计算的盈利基数，假设 2020 年度扣除非经常性损益后的净利润为上述基数基础上分别持平、增长和减少 10%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

(5) 不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

(6) 假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

(7) 在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素；

(8) 上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2020 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；

(9) 每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)、《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》(财会[2014]13号)的有关规定进行计算。

## 2、对主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2019年12月31日 /2019年度	2020年12月31日/2020年度	
		发行前	发行后
期末总股本(股)	477,068,962.00	477,068,962.00	496,068,962
<b>假设 1: 假设公司 2020 年度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润与 2019 年度持平</b>			
归属于母公司的净利润(万元)	2,934.52	2,934.52	2,934.52
归属于母公司的净利润(扣非后)(万元)	2,472.33	2,472.33	2,472.33
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.06
基本每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.06	0.05
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.06	0.05
<b>假设 2: 假设公司 2020 年度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润与 2019 年度上涨 10%</b>			
归属于母公司的净利润(万元)	2,934.52	3,227.97	3,227.97
归属于母公司的净利润(扣非后)(万元)	2,472.33	2,719.56	2,719.56
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.07
基本每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.06	0.06
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.06	0.06
<b>假设 3: 假设公司 2020 年度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润与 2019 年度下降 10%</b>			
归属于母公司的净利润(万元)	2,934.52	2,641.07	2,641.07
归属于母公司的净利润(扣非后)(万元)	2,472.33	2,225.10	2,225.10
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.06
基本每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.05	0.05
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.05	0.05

注:基本每股收益= $P0 \div S$ ,  $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0+NP \div 2+Ei \times Mi \div M0-Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中: P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M0 为报告期月份数; Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

由上表可知, 本次发行完成后, 预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降, 因此, 公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

## (二) 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力, 本次发行完成后, 公司将通过加强募投项目推进力度、提升公司治理水平、加强募集资金管理、严格执行分红政策等措施提升公司运行效率, 以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下:

### 1、加强募集资金的管理, 提高募集资金使用效率

为规范公司募集资金的使用与管理, 确保募集资金的使用规范、安全、高效, 根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定, 公司制定了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》。本次募集资金到账后, 公司将根据相关法规及公司《上

海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金的使用，防范募集资金使用风险；提高募集资金使用效率，全面控制公司经营管理风险，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

## **2、加快募投项目实施进度，尽早实现项目预期效益**

公司本次发行股票募集资金投资项目经充分的调研和论证，符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，随着项目的实施完成，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

在本次发行募集资金到位前，为使募集资金投资项目尽快实施，公司将积极调配资源，提前落实募集资金投资项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将尽快实施募集资金投资项目，确保项目预期收益顺利实现，从而增加以后年度的股东回报，减少本次发行对股东即期回报的影响。

## **3、全面提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本**

公司将完善业务流程，提升对研发、采购、生产、销售各环节的管理精细度，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率以及营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性。通过以上措施，公司将全面提升自身运营效率，降低运营成本，从而提升整体经营业绩。

## **4、严格执行公司的分红政策，优化投资回报机制**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，公司制定了完善、具体的利润分配政策，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

为进一步明确股东分红回报计划，继续引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，积极回报投资者，公司制定了《未来三年（2020-2022年）股东回报规

划》，规划明确了公司股东分红回报规划的具体内容、决策机制以及规划调整的决策程序，强化了中小投资者权益保障机制。

综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，加快募投项目实施进度，尽早实现项目预期效益，采取多种措施持续提升经营业绩，并在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，从而有效降低本次发行对股东即期回报的影响。

### （三）相关主体关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

#### 1、公司控股股东的承诺

公司控股股东上海润欣信息技术有限公司根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

作为润欣科技的控股股东，不越权干预润欣科技经营管理活动，不侵占润欣科技利益。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给润欣科技造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。

#### 2、公司实际控制人的承诺

公司实际控制人郎晓刚、葛琼根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

作为公司的实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

#### 3、公司全体董事、高级管理人员的承诺

公司为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司全体董事及高级管理人员特承诺如下：

（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）对本人的职务消费行为进行约束；

（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司后续推出公司股权激励方案，本人承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）本承诺出具日后至本次发行实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；

（7）作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海润欣科技股份有限公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》盖章页）

上海润欣科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日